

2023年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)

2023年8月10日

コード番号 6266 URL https://www.tazmo.co.jp/ja/ir/index.html

代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)佐藤泰之

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長兼総務部長 (氏名) 吉國 久雄 TEL 086-239-5000

四半期報告書提出予定日 2023年8月10日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2023年12月期第2四半期の連結業績(2023年1月1日~2023年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上	高営業利益		売上高		営業利益		—————————————————————————————————————	親会社株主に 四半期糾	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%		
2023年12月期第2四半期	10,434	19.0	539	58.1	706	59.0	137	89.0		
2022年12月期第2四半期	12,885	32.3	1,289	72.7	1,725	110.0	1,246	125.6		

(注)包括利益 2023年12月期第2四半期 726百万円 (62.1%) 2022年12月期第2四半期 1,915百万円 (134.7%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円銭	円 銭
2023年12月期第2四半期	9.42	
2022年12月期第2四半期	93.21	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2023年12月期第2四半期	43,247	18,122	41.2	1,216.69
2022年12月期	39,397	17,549	43.9	1,188.12

(参考)自己資本 2023年12月期第2四半期 17,809百万円 2022年12月期 17,285百万円

2. 配当の状況

			年間配当金		
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円銭	円銭	円 銭	円銭	円 銭
2022年12月期		0.00		21.00	21.00
2023年12月期		0.00			
2023年12月期(予想)				21.00	21.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2023年12月期の連結業績予想(2023年1月1日~2023年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上	高	営業和	引益	経常和	引益	親会社株主 当期純		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円銭
通期	31,423	29.0	3,118	11.1	3,087	1.6	2,109	6.8	151.07

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 以外の会計方針の変更 : 無 会計上の見積りの変更 : 無 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

期末自己株式数

期中平均株式数(四半期累計)

2023年12月期2Q	14,836,691 株	2022年12月期	14,813,300 株
2023年12月期2Q	199,282 株	2022年12月期	264,282 株
2023年12月期2Q	14,575,874 株	2022年12月期2Q	13,368,484 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大き〈異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1)経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1)四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(重要な後発事象)	9
(セグメント情報等)	10
3. 補足情報	11
(受注状況)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における経営環境は、社会が新型コロナウイルス感染症との共存を図る中で経済活動の正常化が進んだ一方、地政学リスクの高まり、原材料の高騰や不安定な為替相場など、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループが属する半導体業界におきましては、パワー半導体向けの貼合装置及び剥離装置の引き合いは強いものの、リモートワークの普及などに伴い増加していたスマートフォンやパソコン向けの半導体需要が減少し、設備投資が鈍化する動きが見られました。

このような状況のなか当社グループは、中長期的な成長に向けて、顧客ニーズに対応した装置の開発や生産活動 に注力してまいりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は104億34百万円(前年同期比19.0%減)、営業利益5億39百万円(前年同期比58.1%減)、経常利益7億6百万円(前年同期比59.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益1億37百万円(前年同期比89.0%減)となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

(プロセス機器事業)

半導体装置部門につきましては、検収が遅れていることにより、売上高は17億31百万円(前年同期比36.1%減) となりました。

搬送装置部門につきましては、ウェハー搬送ロボットなどの出荷が順調に進んでおり、売上高は39億64百万円 (前年同期比13.9%増)となりました。

洗浄装置部門につきましては、洗浄装置の検収が進み、売上高は16億40百万円(前年同期比33.4%増)となりました。

コーター部門につきましては、当期の後半に検収が集中しており、売上高は5億20百万円(前年同期比79.7%減)となりました。

以上の結果、プロセス機器事業の売上高は78億57百万円(前年同期比21.3%減)、営業利益7億3百万円(前年同期比39.6%減)となりました。

(金型·樹脂成形事業)

金型・樹脂成形事業につきましては、国内の電子部品業界の業績は回復しましたが、中国の景気減速とスマートフォンやパソコン向けの半導体需要が落ち込んだ影響を受けたことから、売上高は7億69百万円(前年同期比5.6%減)、営業利益17百万円(前年同期比36.2%減)となりました。

(表面処理用機器事業)

表面処理用機器事業につきましては、検収が遅延していることから、売上高は18億7百万円(前年同期比13.6%減)、営業損失1億39百万円(前年同期は1億1百万円の営業利益)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は358億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億52百万円増加しました。主な要因は、「棚卸資産」の増加44億42百万円、「その他」の減少5億54百万円によるものであります。有形固定資産は63億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億13百万円増加しました。主な要因は、「その他」の増加1億1百万円によるものであります。無形固定資産は2億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ30百万円増加しました。主な要因は、「ソフトウェア」の増加34百万円によるものであります。投資その他の資産は7億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億47百万円減少しました。主な要因は、「投資有価証券」の減少3億35百万円によるものであります。

これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ38億50百万円増加し、432億47百万円となりました。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は184億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円の減少となりました。主な要因は、「電子記録債務」の減少4億99百万円、「短期借入金」の減少5億92百万円、「未払金」の減少3億6百万円、「未払法人税等」の減少2億円、「製品保証引当金」の減少9百万円、「賞与引当金」の減少90百万円、「有償支給取引に係る負債」の減少5億77百万円、「支払手形及び買掛金」の増加3億37百万円、「契約負債」の増加18億78百万円、「その他」の増加30百万円によるものであります。固定負債は66億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億6百万円の増加となりました。主な要因は、「長期借入金」の増加33億89百万円によるものであります。

これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ32億76百万円増加し、251億24百万円となりました。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は181億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億73百万円の増加となりました。主な要因は、「資本金」の増加61百万円、「為替換算調整勘定」の増加5億33百万円によるものであります。

②当四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ61百万円増加し50億85百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は23億20百万円(前年同期は5億57百万円の収入)となりました。これは、契約負債の増加17億49百万円を主とする資金の増加と、棚卸資産の増加41億29百万円を主とする資金の減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は3億39百万円(前年同期比10.4%減)となりました。これは主に、生産設備の新増設並びに更新のための支出3億56百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は24億97百万円(前年同期比21.6%増)となりました。これは、長期借入金52億円を主とする資金の増加と、短期借入金の返済15億円、長期借入金の返済9億3百万円及び配当金支払い3億10百万円を主とする資金の減少によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績につきましては、顧客からの装置出荷や立上げの延期要請等により装置検収が当初計画より遅延傾向で推移しており、売上高は予想を下回る見込みとなりました。利益面でも、利益率の高い半導体製造装置の検収遅延による売上高の減少により、2023年12月期第2四半期連結累計期間の予想数値が2023年2月13日に公表した予想数値を下回る見込みとなりました。そのため、2023年12月期第2四半期の業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、2023年8月3日公表の「2023年12月期第2四半期連結累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、2023年12月期通期の連結業績につきましては、現時点では達成可能と見込んでおりますので据え置いております。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位	:	千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5, 141, 311	5, 139, 878
受取手形及び売掛金	4, 496, 041	4, 052, 190
電子記録債権	1, 869, 262	2, 378, 799
棚卸資産	17, 983, 655	22, 426, 458
その他	2, 415, 311	1, 861, 104
流動資産合計	31, 905, 581	35, 858, 431
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3, 617, 831	3, 597, 879
機械装置及び運搬具(純額)	791, 135	823, 122
土地	1, 291, 426	1, 291, 426
その他(純額)	567, 391	669, 132
有形固定資産合計	6, 267, 785	6, 381, 560
無形固定資産		
ソフトウエア	138, 991	173, 544
その他	59, 184	55, 245
無形固定資産合計	198, 175	228, 790
投資その他の資産		
投資有価証券	401, 948	66, 898
繰延税金資産	212, 650	287, 283
その他	415, 450	428, 854
貸倒引当金	△4, 576	△4, 799
投資その他の資産合計	1, 025, 472	778, 236
固定資産合計	7, 491, 434	7, 388, 587
資産合計	39, 397, 015	43, 247, 018
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1, 725, 959	2, 063, 736
電子記録債務	4, 350, 479	3, 851, 399
短期借入金	5, 279, 474	4, 687, 431
未払金	1, 585, 551	1, 278, 606
未払法人税等	505, 697	305, 420
契約負債	3, 691, 848	5, 570, 047
賞与引当金	318, 104	227, 653
製品保証引当金	301, 542	292, 446
株式給付引当金	5, 751	4, 792
有償支給取引に係る負債	577, 364	-
その他	121, 592	152, 042
流動負債合計	18, 463, 365	18, 433, 577
固定負債		
長期借入金	2, 643, 216	6, 032, 223
株式給付引当金	251, 593	267, 924
役員退職慰労引当金	21, 177	23, 178
役員株式給付引当金	122, 187	-
退職給付に係る負債	66, 417	68, 225
資産除去債務	171, 580	193, 068
その他	108, 214	106, 213
固定負債合計	3, 384, 387	6, 690, 833
負債合計	21, 847, 753	25, 124, 411
純資産の部		
株主資本		
資本金	3, 495, 400	3, 556, 896
資本剰余金	3, 430, 855	3, 415, 301
利益剰余金	10, 151, 848	9, 978, 126
自己株式	△434, 156	△316, 660
株主資本合計	16, 643, 947	16, 633, 664
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	150	71
為替換算調整勘定	641, 870	1, 175, 491
その他の包括利益累計額合計	642, 020	1, 175, 562
非支配株主持分	263, 294	313, 381
純資産合計	17, 549, 262	18, 122, 607

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円) 前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 (自 2023年1月1日 2023年6月30日) 至 2022年6月30日) 至 売上高 10, 434, 328 12, 885, 557 売上原価 9, 415, 582 7, 572, 078 売上総利益 3, 469, 975 2, 862, 249 販売費及び一般管理費 2, 180, 555 2, 322, 542 営業利益 1, 289, 419 539, 706 営業外収益 22,700 受取利息 8,692 為替差益 439,866 163,4254, 389 1, 164 補助金収入 その他 14,530 8, 159 営業外収益合計 467, 477 195, 449 営業外費用 支払利息 16,849 23, 234 その他 14,052 5,020 営業外費用合計 30,901 28, 254 経常利益 1, 725, 996 706, 901 特別利益 64, 999 14, 582 固定資産売却益 特別利益合計 64, 999 14, 582 特別損失 投資有価証券評価損 335, 030 335, 030 特別損失合計 税金等調整前四半期純利益 1, 790, 996 386, 453 法人税等 524, 930 226, 867 四半期純利益 1, 266, 065 159, 585 20, 029 非支配株主に帰属する四半期純利益 22, 265 親会社株主に帰属する四半期純利益 1, 246, 035 137, 320

(四半期連結包括利益計算書) (第2四半期連結累計期間)

(第2四半期連結累計期間)		
		(単位:千円)
	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
四半期純利益	1, 266, 065	159, 585
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△60	△79
為替換算調整勘定	649, 912	566, 832
その他の包括利益合計	649, 852	566, 753
四半期包括利益	1, 915, 917	726, 339
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1, 858, 561	670, 862
非支配株主に係る四半期包括利益	57, 356	55, 476

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

		(単位:1円)
	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1, 790, 996	386, 453
減価償却費	330, 816	353, 394
固定資産売却益	△64, 999	△14, 582
投資有価証券評価損益(△は益)	_	335, 049
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4, 905	223
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△58, 498	△90, 450
株式給付引当金の増減額	24, 976	25, 437
役員株式給付引当金の増減額	15, 420	$\triangle 122, 187$
売上債権の増減額 (△は増加)	639, 978	43, 140
棚卸資産の増減額 (△は増加)	$\triangle 2, 120, 297$	△4, 129, 132
仕入債務の増減額(△は減少)	1, 777, 677	△297, 424
契約負債の増減額(△は減少)	$\triangle 1,042,527$	1, 749, 035
その他	$\triangle 463,005$	△127, 260
小計	835, 442	△1, 888, 303
法人税等の支払額	\triangle 269, 509	△431, 839
その他の支出	△8, 156	△534
営業活動によるキャッシュ・フロー	557, 776	$\triangle 2, 320, 676$
投資活動によるキャッシュ・フロー	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• •
定期預金の払戻による収入	68, 229	54, 979
投資有価証券の取得による支出	△60	<u>△</u> 79
有形固定資産の売却による収入	65, 000	19, 690
有形固定資産の取得による支出	△441, 360	△356, 264
無形固定資産の取得による支出	△80, 169	△58, 512
その他	9, 912	1, 123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△378, 448	△339, 063
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u> </u>	
短期借入金の純増減額(△は減少)	$\triangle 1, 100, 000$	$\triangle 1,500,000$
長期借入れによる収入	3, 000, 000	5, 200, 000
長期借入金の返済による支出	△855, 118	△903, 036
社債の償還による支出	△300, 000	_
株式の発行による収入	1, 530, 385	_
配当金の支払額	△216, 152	△310, 526
自己株式の売却による収入	-	7, 686
その他	△4, 374	3, 479
財務活動によるキャッシュ・フロー	2, 054, 739	2, 497, 603
現金及び現金同等物に係る換算差額	225, 521	223, 376
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2, 459, 588	61, 239
現金及び現金同等物の期首残高	2, 981, 549	5, 024, 659
現金及び現金同等物の四半期末残高	5, 441, 137	5, 085, 898
Service Service data da la se en 1 MANAME	0, 111, 101	0, 000, 000

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記) 該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用 後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自2022年1月1日 至2022年6月30日) 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	幸 プロセス機器 事業	報告セグメント 金型・樹脂 成形事業	表面処理用 機器事業	合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
売上高						
半導体装置	2, 709, 763	_	_	2, 709, 763	_	2, 709, 763
搬送装置	3, 479, 822	_	_	3, 479, 822	_	3, 479, 822
洗浄装置	1, 229, 673	_	_	1, 229, 673	_	1, 229, 673
コーター	2, 558, 621	_	_	2, 558, 621	_	2, 558, 621
金型・樹脂成形	_	815, 763	_	815, 763	_	815, 763
表面処理用機器	_		2, 091, 912	2, 091, 912		2, 091, 912
顧客との契約から生じる 収益	9, 977, 881	815, 763	2, 091, 912	12, 885, 557	_	12, 885, 557
その他の収益	_	_	_	_	_	_
外部顧客への売上高	9, 977, 881	815, 763	2, 091, 912	12, 885, 557		12, 885, 557
セグメント間の内部売上 高又は振替高	135, 095	105, 181	_	240, 277	△240, 277	_
11 I	10, 112, 976	920, 944	2, 091, 912	13, 125, 834	△240, 277	12, 885, 557
セグメント利益	1, 163, 600	27, 527	101, 232	1, 292, 360	△2, 940	1, 289, 419

- (注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。
 - 2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
- Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自2023年1月1日 至2023年6月30日) 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント				調整額	四半期連結 損益計算書
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用 機器事業	合計	調整領 (注) 1	計上額 (注) 2
売上高						
半導体装置	1, 731, 675	_	_	1, 731, 675	_	1, 731, 675
搬送装置	3, 964, 173	_	_	3, 964, 173	_	3, 964, 173
洗浄装置	1, 640, 840	_	_	1, 640, 840	_	1, 640, 840
コーター	520, 555	_	_	520, 555	_	520, 555
金型・樹脂成形	_	769, 951	_	769, 951	_	769, 951
表面処理用機器	_	_	1, 807, 131	1, 807, 131	_	1, 807, 131
顧客との契約から生じる 収益	7, 857, 244	769, 951	1, 807, 131	10, 434, 328	_	10, 434, 328
その他の収益	_	_	_	_		_
外部顧客への売上高	7, 857, 244	769, 951	1, 807, 131	10, 434, 328	_	10, 434, 328
セグメント間の内部売上 高又は振替高	369, 689	265, 926	38, 037	673, 653	△673, 653	_
11	8, 226, 934	1, 035, 878	1, 845, 168	11, 107, 981	△673, 653	10, 434, 328
セグメント利益又は損失 (△)	703, 278	17, 571	△139, 810	581, 040	△41, 333	539, 706

- (注) 1. セグメント利益又は損失 (△) の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。
 - 2. セグメント利益又は損失 (△) は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3. 補足情報

(受注状況)

当第2四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

1. 受注高

セグメントの名称		前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)	前年同期比
		(千円)	(千円)	.,*,
プロセス機器事業		12, 743, 516	7, 534, 346	59. 1
	半導体装置	4, 912, 726	3, 549, 128	72. 2
	搬送装置	5, 094, 161	3, 027, 593	59. 4
	洗浄装置	2, 073, 588	645, 782	31. 1
	コーター	663, 040	311, 842	47. 0
<u>a</u>	2型・樹脂成形事業	834, 081	683, 088	81.9
表面処理用機器事業		3, 029, 178	1, 051, 818	34. 7
合計		16, 606, 775	9, 269, 254	55. 8

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 受注残高

	セグメントの名称	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) (千円)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) (千円)	前年同期比(%)
7	プロセス機器事業	27, 067, 482	29, 311, 693	108. 3
	半導体装置	7, 572, 071	12, 127, 475	160. 2
	搬送装置	5, 725, 867	5, 082, 244	88.8
	洗浄装置	8, 833, 406	7, 649, 201	86.6
	コーター	4, 936, 136	4, 452, 772	90.2
\$	企型・樹脂成形事業	366, 066	239, 599	65. 5
ā	近 処理用機器事業 3,613,702		7, 608, 820	210.6
合計		合計 31,047,251		119. 7

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。